

证券代码：688807

证券简称：优迅股份

厦门优迅芯片股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	平安资产、新华资产、 赋格投资、 Anatole Capital Management 、上海东方证券资产管理、 上海景林资产、 东方阿尔法基金、中信证券、 中邮创业基金、 信达澳亚 、 兴全基金 、 兴证全球基金、华商基金、 华安基金、华宝基金、 华福证券、华金证券、南土资产、南方基金、 国寿安保基金、 国投基金、国泰基金、国泰海通证券、国海证券、国盛证券 、 国联基金、国联安基金、天弘基金、天风证券、 富国基金、 工银瑞信、平安养老保险、 易方达、 星石投资、 民生加银基金、汇安基金、浙商证券、 浙商资管、海富通基金、淡水泉投资、 淳厚基金、盘京投资、 磐泽资产、英领投资、诺德基金、运舟资本、 长城基金、群盛投资、中加基金等
时间	2026年4月17日下午2点-3点半
地点	厦门市软件园观日路54号之二二楼公司会议室
上市公司接待人员	董事长：柯炳焄 董事、总经理：柯腾隆 副总经理：林智、陈哲 董事会秘书兼财务总监：杨霞 投资总监：廖丽玲
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：请简要介绍公司情况？ 公司成立于2003年2月，总部位于厦门，是中国首批专业从事光通信前端高速收发芯片的设计公司，参与制定了国家及行业标准数十项，拥有国内外自主知识产权百余项，

是国家知识产权优势企业，国家规划布局内集成电路设计企业，国家专精特新“小巨人”企业，国家制造业单项冠军，是国内光通信芯片行业领军企业。

优迅股份致力于深耕无线接入、云计算、光接入网、数据中心、AI 计算和骨干网等领域，为全球光模块厂商和系统设备商提供速率涵盖 155Mbps~800Gbps/1.6Tbps 高速收发芯片解决方案，拥有从芯片级、器件级、模块级、终端级、系统级完整的测试验证开发平台。多年来经过核心技术团队持续研发和攻关，在相关技术领域已达到国际先进、国内领先水平。完成国家多项科研项目，与国内外知名运营商、系统设备商、模块商建立了战略合作伙伴关系。与全球多家著名半导体晶圆制造厂、封装测试厂建立了长期稳定的合作关系。

第二部分：Q&A

1、公司单波 100G、200G 电芯片产品（应用于 400G、800G、1.6T 光模块）进度如何？

答：公司单波 100Gbps 系列电芯片（主要包括 TIA、Driver 产品）进展顺利，正在进行工程片流片，预计今年三季度实现芯片回片，并同步推进客户验证工作。同时，公司已搭建完成单波 100G 速率产品的研发与测试技术平台，完成高速率 PAM4 线性收发芯片核心 IP 的性能验证，形成完整的单波 100G PAM4 收发芯片设计开发能力，为后续产品规模化量产奠定坚实基础。单波 200Gbps 方面，公司围绕 1.6T 光模块应用积极布局下一代速率产品，重点研发跨阻放大器、VCSEL 激光器驱动器，以及面向 LPO/NPO 架构的 MZ 调制器驱动器等核心芯片，目前已进入样品测试阶段。

	<p>单波 100G、单波 200G 产品大量采用线性驱动技术，相关方案可广泛适配 LPO、NPO、CPO 等下一代光互联架构，应用场景具备较强延展性。</p> <p>2、在高速率数据中心领域，LPO 未来的占比将达到多少？公司是否有做 DSP 的计划？</p> <p>答：当前国内头部互联网及云厂商已陆续开展 LPO 技术布局，随着高速率光互联需求持续提升，预计未来 LPO 在高速率数据中心领域的应用占比有望进一步提升。</p> <p>DSP 芯片方面，公司目前暂无相关研发计划，未来将结合行业技术演进、市场需求及自身战略规划，综合评估相关布局可能性。</p> <p>3、公司的同行业竞争对手是以 IDM 还是 Fabless 为主？</p> <p>答：在光通信电芯片领域，基本都以 Fabless 模式为主。</p> <p>4、公司在 128G 相干光通信这块的进度如何？相干下沉的应用领域机会在哪里？</p> <p>答：公司 128G 波特率相干 TIA 及 Driver 芯片研发推进顺利，目前已完成针对部分头部客户的送样验证工作，且顺利获得客户后续深度合作意向，产品商业化落地进程稳步推进。应用领域方面，相干下沉技术的应用场景具备较强延展性，除传统骨干网、城域网领域外，DCI（数据中心互联）领域将成为相干下沉技术核心增量应用场景，未来市场空间广阔，公司也将紧抓这一领域的市场机遇，持续推进相关产品的技术迭代与客户拓展。</p> <p>5、对应到 LPO、NPO、CPO 等技术演进方向上，公司电芯片产品价值量将如何变化？</p>
--	---

答：随着 LPO、NPO、CPO 等下一代光互联技术的持续演进，对高速线性电芯片的性能要求与集成度不断提升，公司相关 TIA、Driver 等核心电芯片产品的价值量有望实现显著提升。

6、了解到公司在电信领域有着非常深厚的技术积淀，请问高速率数通领域与电信领域在技术难度上有何不同？公司在电信侧的能力是否在高速率数通领域能得到复用？

答：公司自接入网领域起步，同时较早布局数通市场，相关技术从 10G、25G 代际便已持续积累。近年来随着智算中心高速发展，单波 100G、200G 等高端方案成为行业焦点，而公司在高速信号处理、小信号检测、低噪声设计等核心技术上与数通领域一脉相承，相关能力可直接复用于高速率数据中心场景。早期，公司便依托国家 863 计划、科技部重大专项及各级科研项目，前瞻性开展高速数通芯片研发，已形成深厚技术储备。在 2025 年深圳光博会上，公司成功完成 800G VR8 及硅光 DR8 高速方案现场演示，获得行业高度认可，充分体现了技术前瞻性。在工艺平台方面，单波 100G 及以上速率产品普遍采用锗硅工艺，公司与晶圆厂保持长期稳定的深度合作，工艺导入与量产切换顺畅，电信领域积累的高端工艺开发经验同样可在数通领域高效复用。

7、基于国产替代的要求，从客户角度，是否会加速导入国产光通信电芯片？

答：在国产化替代趋势下，国内客户对国产光通信电芯片的导入意愿与导入节奏均呈现明显加速态势。公司深耕光通信电芯片领域二十余年，已与多家头部系统厂商在接入网、数通、骨干网等多个领域建立深度合作；同时，国内头部互联

网及云厂商均已逐步将公司纳入国产化供应链体系，相关产品正稳步导入，并开展长期深度的技术协同与合作。

8、公司产品 TIA、Driver 是否会紧缺以及未来是否会涨价？

答：当前行业内 TIA、Driver 产品整体处于偏紧状态，尤其是高速率电芯片普遍采用锗硅工艺，全球锗硅晶圆产能整体紧张，进一步加剧了供给端压力；公司与核心供应链伙伴保持长期稳定合作，在产能紧张阶段能够获得稳定支持，保障核心产品交付；同时，公司也在积极布局多元化工艺路线；目前国内锗硅工艺产线正加快建设，待相关工艺成熟后，公司将根据产业进展适时开展合作，进一步提升供应链安全与供给能力。

9、国内模拟大厂譬如圣邦，以信号链集成电路、电源产品等为主，如果圣邦往我们高速率电芯片这个方向切入，会有什么阻碍？

答：国内同类模拟厂商在电源管理类芯片领域具备较强优势，以圣邦为例，其产品主要聚焦于高速光模块电源管理方向，与公司业务赛道存在明显差异。公司核心聚焦光通信信号链路领域，在高速小信号处理、低噪声放大、时钟数据恢复（CDR）等方面形成核心技术壁垒。从电源管理芯片切入高速光通信电芯片，在技术原理、设计方法论、工艺平台及验证体系上均存在显著差异，跨界拓展具备较高技术难度。

10、公司创始人在 03 年创业之前并非业内人士，是什么样的契机进入光通信电芯片行业？

答：公司创始人柯董事长的创业契机，与其个人成长及时代机遇紧密相关。柯董事长早年曾服役于部队（通信兵），积累了基础的通信领域认知；后续考入中国政法大学（前身为北

	<p>京政法大学), 毕业后进入厦门大学从事法律相关工作。上世纪 90 年代, 柯董事长响应时代号召下海创业, 初期聚焦高科技领域投资, 凭借精准的行业判断获得了原始积累, 随后逐步从投资人转型为实业经营者, 于 2003 年开启了优迅股份的创业之路。公司的成长, 既离不开团队的坚守与努力, 更有幸赶上了国家集成电路产业快速发展的黄金时代, 同时在外部的产业环境变化的背景下, 依托自主研发与持续创新, 逐步在光通信电芯片领域站稳脚跟、发展壮大。</p> <p>11、公司在车载领域的布局是怎样的?</p> <p>答: 随着车载光互联、光纤化应用趋势逐步明确, 公司已在车载领域展开前瞻性布局。目前正与国内主流 Tier1 厂商及整车企业开展联合研发与合作, 相关产品处于实验验证阶段, 为后续规模化上车奠定基础。</p> <p>接待过程中, 公司与投资者进行了充分的交流与沟通, 并严格按照《投资者关系管理制度》等规定, 保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况, 同时要求签署调研《承诺书》。</p>
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容, 不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的承诺和保证, 敬请广大投资者注意投资风险。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动不涉及应当披露重大信息。
日期	2026 年 04 月 17 日